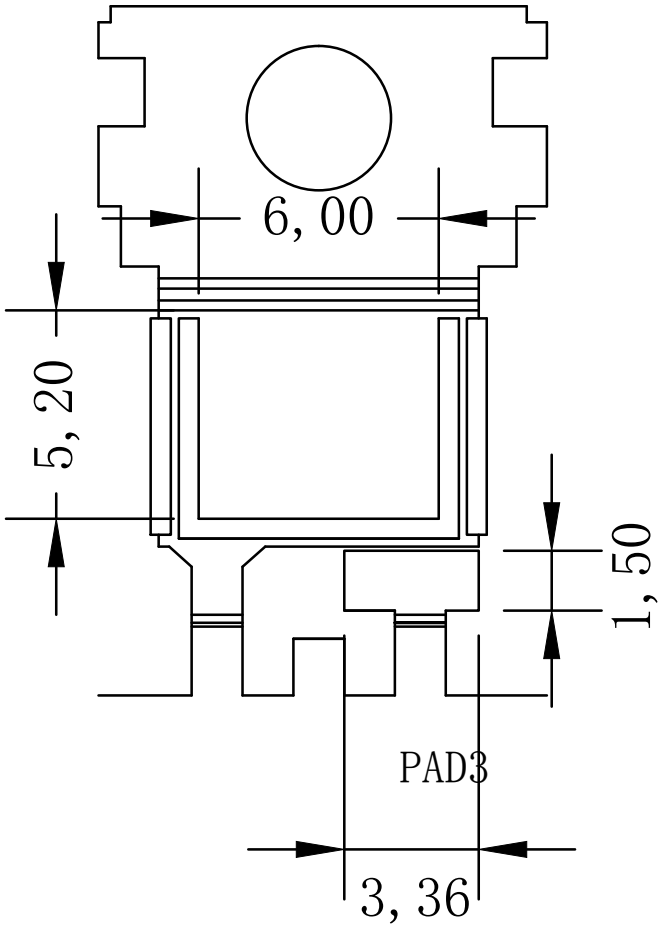
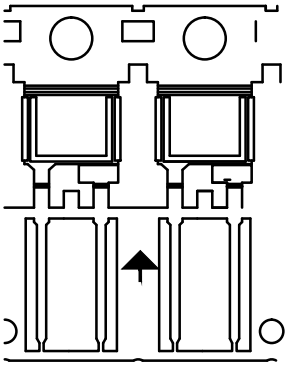
装片及键合配线图





产品信息		装片信息		键合信息	
封装形式		L/F型号		总焊线数	
产品名称		装片胶		Min. BPO (um)	
芯片名称				Min. BPP (um)	
				打线材质	
				打线直径	
		芯片大小(um)			
		芯片厚度 (um)		铝层厚度	

版本	年月日	变更内容	拟制	审查	批准	图 号	